

---

**招商证券股份有限公司**  
**关于深圳丹邦科技股份有限公司**  
**使用募集资金对子公司增资的保荐意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“公司”）非公开发行业股票的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对丹邦科技使用募集资金向全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）增资事宜进行了审慎核查，发表保荐意见如下：

**一、本次增资情况概述**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2013]1153号）文核准，公司于2013年9月向特定对象发行2264万股人民币普通股（A股），价格为26.50元/股，募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,840.00元后，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所2013年9月24日出具的天职业字[2013]679号《验资报告》验证确认。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行的募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”将由广东丹邦作为主体实施，根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》，公司此次拟投入募集资金对广东丹邦进行增资，增资金额为人民币58,096.816万元，其中2,000.00万元增加注册资本，剩余56,096.816万元计入资本公积，广东丹邦另一股东丹邦科技（香港）有限公司本次不增资。

**二、增资子公司的基本情况**

公司名称：广东丹邦科技有限公司

营业执照注册号：441900400115250

---

法定代表人：刘萍

公司类型：有限责任公司

注册资本：13,000万元

成立日期：2009年8月25日

营业期限：有效期截至2059年8月25日

公司地址：东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18

经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装基板），并提供上述产品的技术咨询及相关配套业务。

股权结构：丹邦科技持有广东丹邦90.38%股权，丹邦科技（香港）持有广东丹邦9.62%股权。

### 三、本次增资的目的及资金来源

本次增资是公司根据《非公开发行A股股票预案（修订版）》及第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》，为保障募集资金项目顺利实施，为有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。本次增资资金来源于公司非公开发行A股股票募集的资金。

### 四、丹邦科技拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序

根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》，公司拟以本次募集资金向全资子公司广东丹邦增资。公司本次以本次募集资金向全资子公司广东丹邦增资事项无需提交公司股东大会审议批准。亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后，公司占广东丹邦的股权为91.66%。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：丹邦科技本次使用募集资金向全资子公司广东丹邦增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司

---

的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意丹邦科技本次使用募集资金向全资子公司广东丹邦增资事项。

---

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资的保荐意见》之盖章页）

保荐代表人：

杨柏龄\_\_\_\_\_

蒋 欣\_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

2013年10月29日